

# 半導体検査技術

# 1. 背景/概要/目的

背景	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 電子システムの開発において、要求される機能・性能の実現は必須であるが、競争激化の背景から開発速度に対する重要性は増している。</li><li>◆ 一方でハードウェアやソフトウェア開発の難易度が高まっていることから、自前開発へのリソースの集中と信頼できるパートナーとの有機的な連携が開発速度の向上の重要な鍵となっている。</li></ul>
概要	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 電子システムの速攻開発の支援として、<b>試作・量産から評価解析まで幅広く対応</b>できるパートナーが有望である。</li><li>◆ 本テーマでは、<b>株式会社デンケン</b>のエレクトロニクス事業部の<b>パッケージ組立</b>の<b>受託サービス</b>の活用を提案する。</li></ul>
目的	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 電子システムに搭載される半導体製品の<b>パッケージ組立</b>の全般をサポートするターンキーサービスを紹介する。</li><li>◆ その一環としての半導体製品の「<b>外観検査</b>」、「<b>電気テスト</b>」、「<b>非破壊検査</b>」、「<b>破壊検査</b>」を紹介する。</li><li>◆ デンケン社の本機能への要望、コメントを募集する。</li></ul>